

# Установка лазерного реболинга Seamark ZM-ZQ1520

Установка лазерного реболинга Seamark ZM-ZQ1520

## Цена:

Цена по запросу

## Описание

Система автоматического реболинга ZM-ZQ1520 предназначена для монтажа шариков припоя микросхем BGA и их оплавление с помощью лазера. Система позволяет автоматизировать процесс реболинга (размером от 0,2 до 0,76 мм) со свинцовых на бессвинцовые и наоборот. Для работы не требуется применение трафаретов .

Полусферический вывод оплавляется оптоволоконным лазером над подающей головкой в среде инертного газа, для предотвращения окисления. Точность монтажа шариков позволяет применять эту технологию во многих сферах электронной промышленности.

Сферы применения:

- Микроэлектроника: гибкие подложки мобильных телефонов и цифровых камер, устройства управления голосом, межмодульные паяные соединения, пайка сенсоров;
- Специальное назначение: авионика, ракетостроение, другие сферы применения высокоточной пайки;
- Производство компонентов: Flip Chip, BGA, CSP, панельки, разъемы;

Преимущества:

1. Процесс нагрева и падения капель непродолжителен и может быть завершен за 0,2 с;
2. Шарик припоя расплавляется в наконечнике без разбрызгивания;
3. Нет необходимости в применении флюсов;
4. Минимальный диаметр шарика припоя составляет 0,2 мм, что соответствует современным тенденциям в электронике;
5. Высокое качество пайки и производительность;

6. Благодаря системе позиционирования ( камера CCD) он подходит для крупносерийного SMT производства.

### Характеристики:

Мощность лазера	75 Вт
Длина волны лазера	1064 нм
Точность позиционирования / пайки	$\pm 10$ мкм
Размеры применимых шариков	0,2 - 0,76 мм
Система управления	Контроллер и обработка изображения на ПК
Рабочая зона по X/Y	200 x 150 мм
Паспортная производительность (UPH)	10 000 шариков в час (3 шарика в секунду)
Выход годных	$\geq 99\%$ (< 10 000 DPM)
Внешние требования	Электропитание (< 2 кВт), сжатый воздух, азот
Габаритные размеры оборудования	800 x 850 x 900 мм
Вес	150 кг